

10A、600V N沟道增强型场效应管

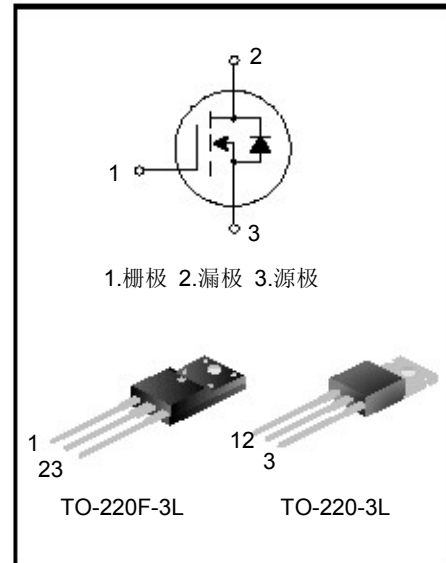
描述

SVF10N60AT/F N沟道增强型高压功率MOS场效应晶体管采用SL电子F-Cell™平面高压VDMOS 工艺技术制造。先进的工艺及条状的原胞设计结构使得该产品具有较低的导通电阻、优越的开关性能及很高的雪崩击穿耐量。

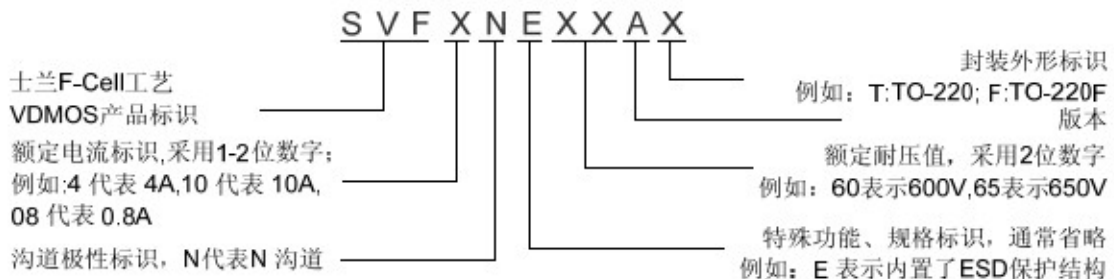
该产品可广泛应用于 AC-DC 开关电源, DC-DC 电源转换器, 高压 H 桥 PWM 马达驱动。

特点

- * 10A, 600V, $R_{DS(on)}$ (典型值)=0.60Ω@ $V_{GS}=10V$
- * 低栅极电荷量
- * 低反向传输电容
- * 开关速度快
- * 提升了 dv/dt 能力



命名规则



产品规格分类

产品名称	封装形式	打印名称	材料	包装
SVF10N60AT	TO-220-3L	SVF10N60AT	无铅	料管
SVF10N60AF	TO-220F-3L	SVF10N60AF	无铅	料管



SVF10N60AT/F 说明书

极限参数(除非特殊说明, $T_c=25^\circ\text{C}$)

参 数	符号	参数范围		单位
		SVF10N60AT	SVF10N60AF	
漏源电压	V_{DS}	600		V
栅源电压	V_{GS}	± 30		V
漏极电流	I_D	$T_c=25^\circ\text{C}$		A
		10		
		$T_c=100^\circ\text{C}$		
		6		
漏极脉冲电流	I_{DM}	40		A
耗散功率 ($T_c=25^\circ\text{C}$) - 大于 25°C 每摄氏度减少	P_D	180	51	W
		1.44	0.41	W/ $^\circ\text{C}$
单脉冲雪崩能量 (注 1)	E_{AS}	792.50		mJ
工作结温范围	T_J	$-55\sim+150$		$^\circ\text{C}$
贮存温度范围	T_{stg}	$-55\sim+150$		$^\circ\text{C}$

热阻特性

参 数	符号	参数范围		单位
		SVF10N60AT	SVF10N60AF	
芯片对管壳热阻	$R_{\theta JC}$	0.69	2.45	$^\circ\text{C}/\text{W}$
芯片对环境的热阻	$R_{\theta JA}$	62.50	120	$^\circ\text{C}/\text{W}$

电性参数(除非特殊说明, $T_c=25^\circ\text{C}$)

参 数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
漏源击穿电压	BBV_{DSS}	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$	600	--	--	V
漏源漏电流	I_{DSS}	$V_{DS}=600V, V_{GS}=0V$	--	--	1.0	μA
栅源漏电流	I_{GSS}	$V_{GS}=\pm 30V, V_{DS}=0V$	--	--	± 100	nA
栅极开启电压	$V_{GS(th)}$	$V_{GS}=V_{DS}, I_D=250\mu A$	2.0	--	4.0	V
导通电阻	$R_{DS(on)}$	$V_{GS}=10V, I_D=5A$	--	0.60	0.75	Ω
输入电容	C_{iss}	$V_{DS}=25V, V_{GS}=0V,$ $f=1.0\text{MHZ}$	--	1469	--	pF
输出电容	C_{oss}		--	163	--	
反向传输电容	C_{rss}		--	3.61	--	
开启延迟时间	$t_{d(on)}$	$V_{DD}=300V, I_D=10A,$ $R_G=25\Omega$ (注 2, 3)	--	36.53	--	ns
开启上升时间	t_r		--	54.80	--	
关断延迟时间	$t_{d(off)}$		--	81.67	--	
关断下降时间	t_f		--	40.33	--	
栅极电荷量	Q_g	$V_{DS}=480V, I_D=10A,$ $V_{GS}=10V$ (注 2, 3)	--	23.70	--	nC
栅极-源极电荷量	Q_{gs}		--	7.92	--	
栅极-漏极电荷量	Q_{gd}		--	7.07	--	



源-漏二极管特性参数

参 数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
源极电流	I_S	MOS 管中源极、漏极构成的反偏 P-N 结	--	--	10	A
源极脉冲电流	I_{SM}		--	--	40	
源-漏二极管压降	V_{SD}	$I_S=10A, V_{GS}=0V$	--	--	1.3	V
反向恢复时间	T_{rr}	$I_S=10A, V_{GS}=0V,$ $dI/dt=100A/\mu s$ (注 2)	--	450	--	ns
反向恢复电荷	Q_{rr}		--	4.2	--	μC

注:

1. $L=30mH, I_{AS}=6.54A, V_{DD}=160V, R_G=25\Omega$, 开始温度 $T_J=25^\circ C$;
2. 脉冲测试: 脉冲宽度 $\leq 300\mu s$, 占空比 $\leq 2\%$;
3. 基本上不受工作温度的影响。



典型特性曲线

图1. 输出特性

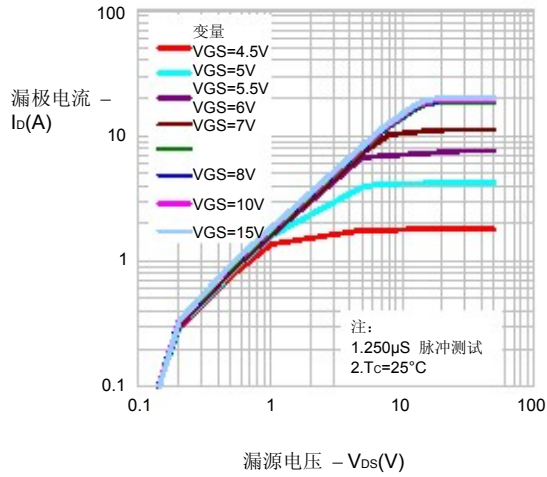


图2. 传输特性

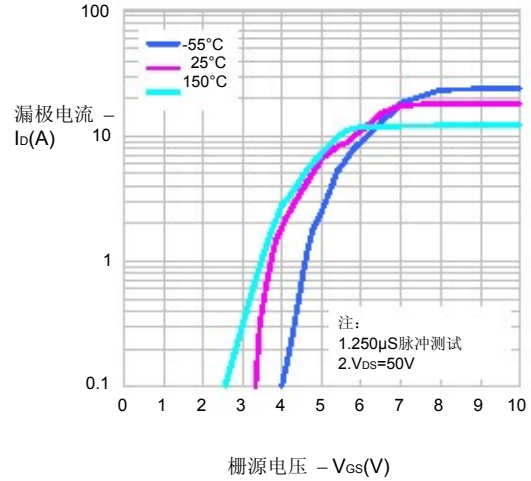


图3. 导通电阻vs.漏极电流

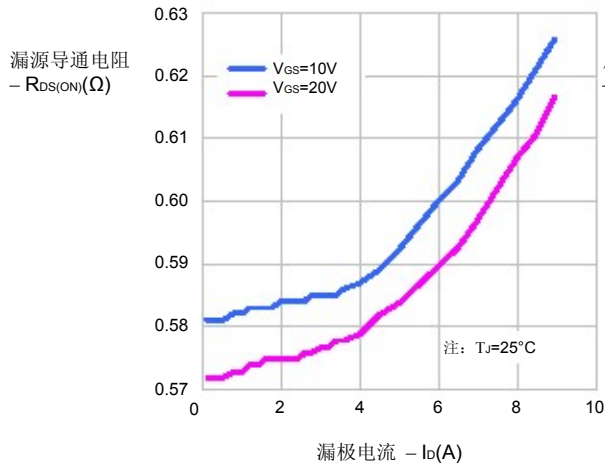


图4. 体二极管正向压降vs. 源极电流、温度

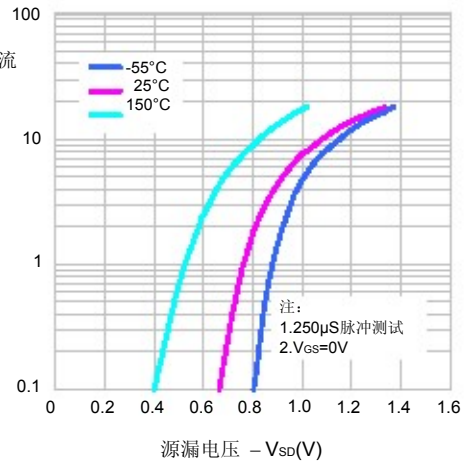


图5. 电容特性

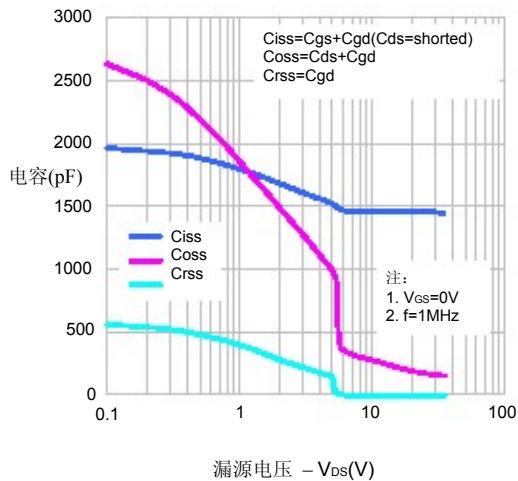
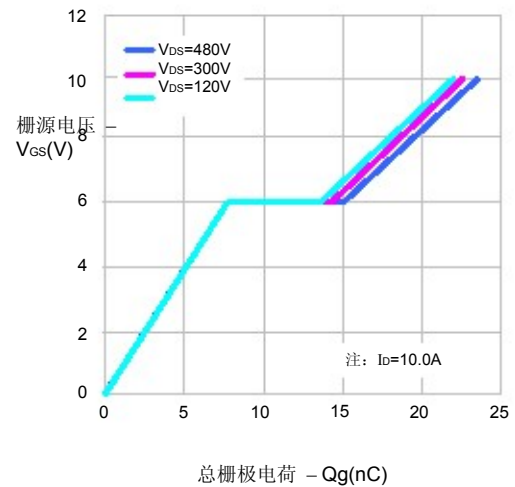


图6. 电荷量特性

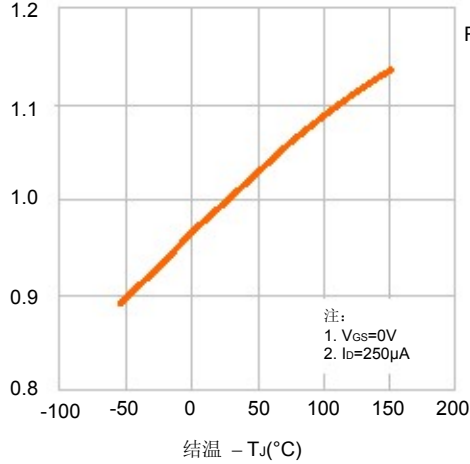




典型特性曲线 (续)

漏源击穿电压
(标准化) - 1.2
 B_{VDS} (V)

图7. 击穿电压vs.温度特性



漏源导通电阻
(标准化) 3.0
 $R_{DS(ON)}$ (Ω)

图8. 导通电阻vs.温度特性

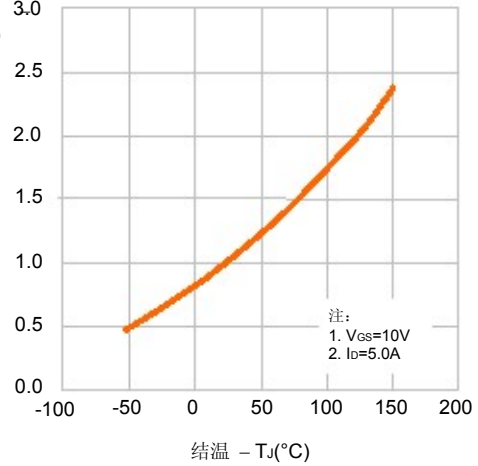


图9-1. 最大安全工作区域(SVF10N60AT)

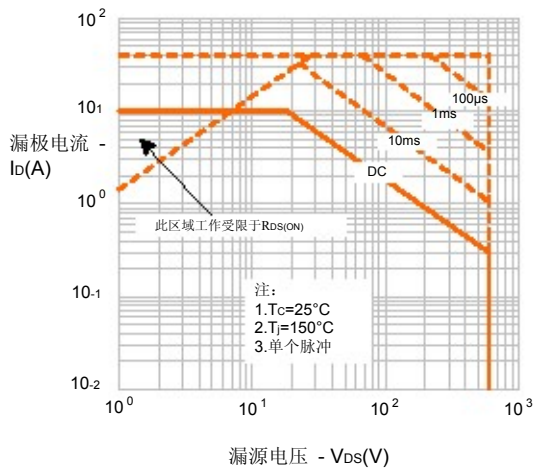


图9-2. 最大安全工作区域(SVF10N60AF)

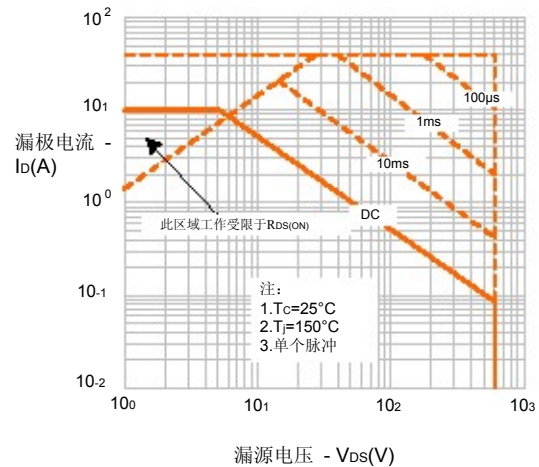
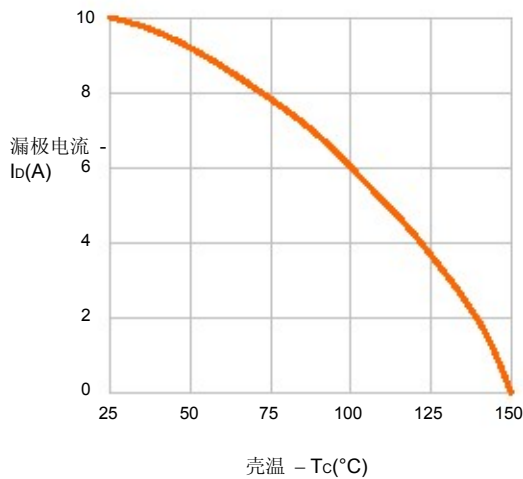


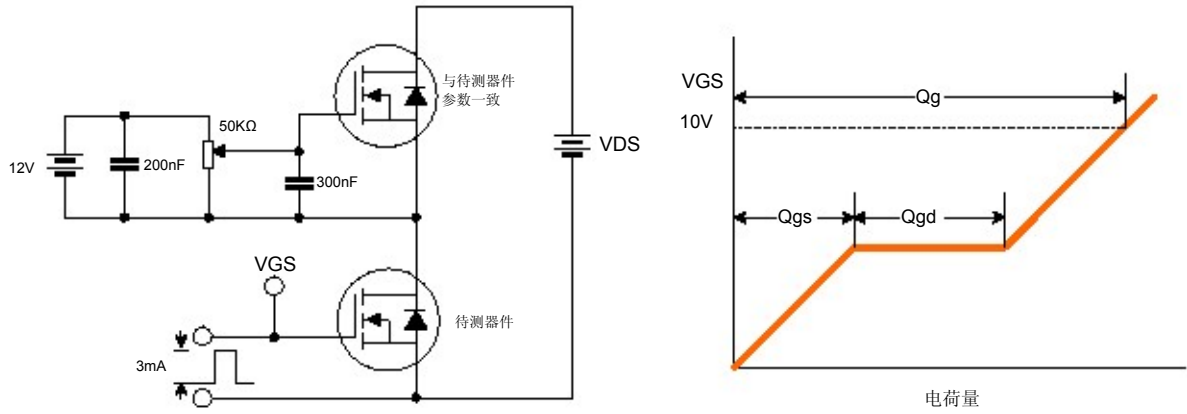
图10. 最大漏极电流vs. 壳温



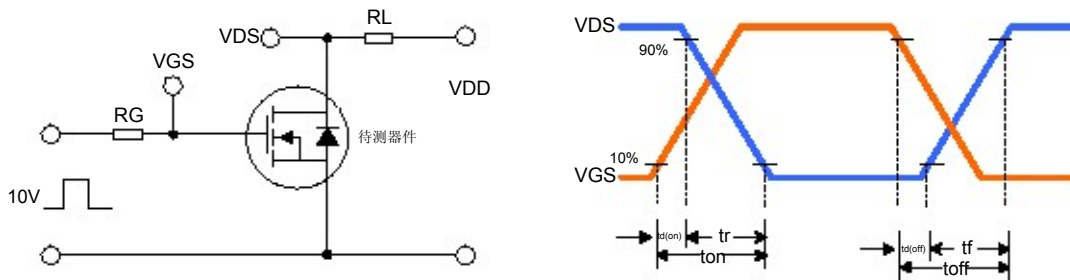


典型测试电路

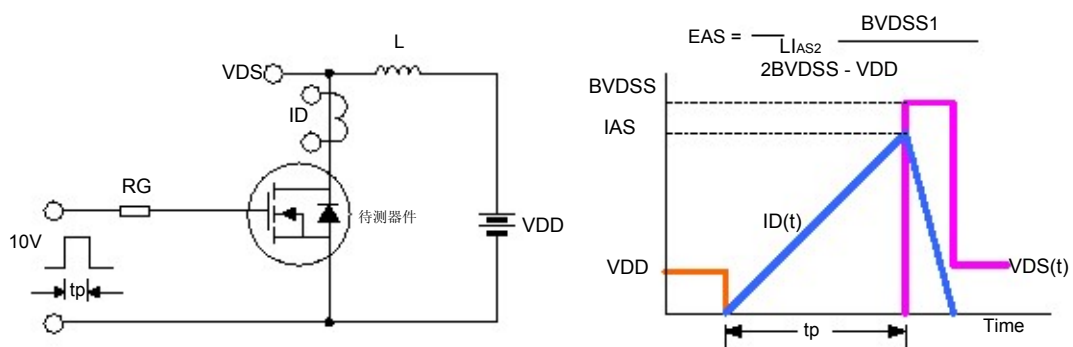
栅极电荷量测试电路及波形图



开关时间测试电路及波形图

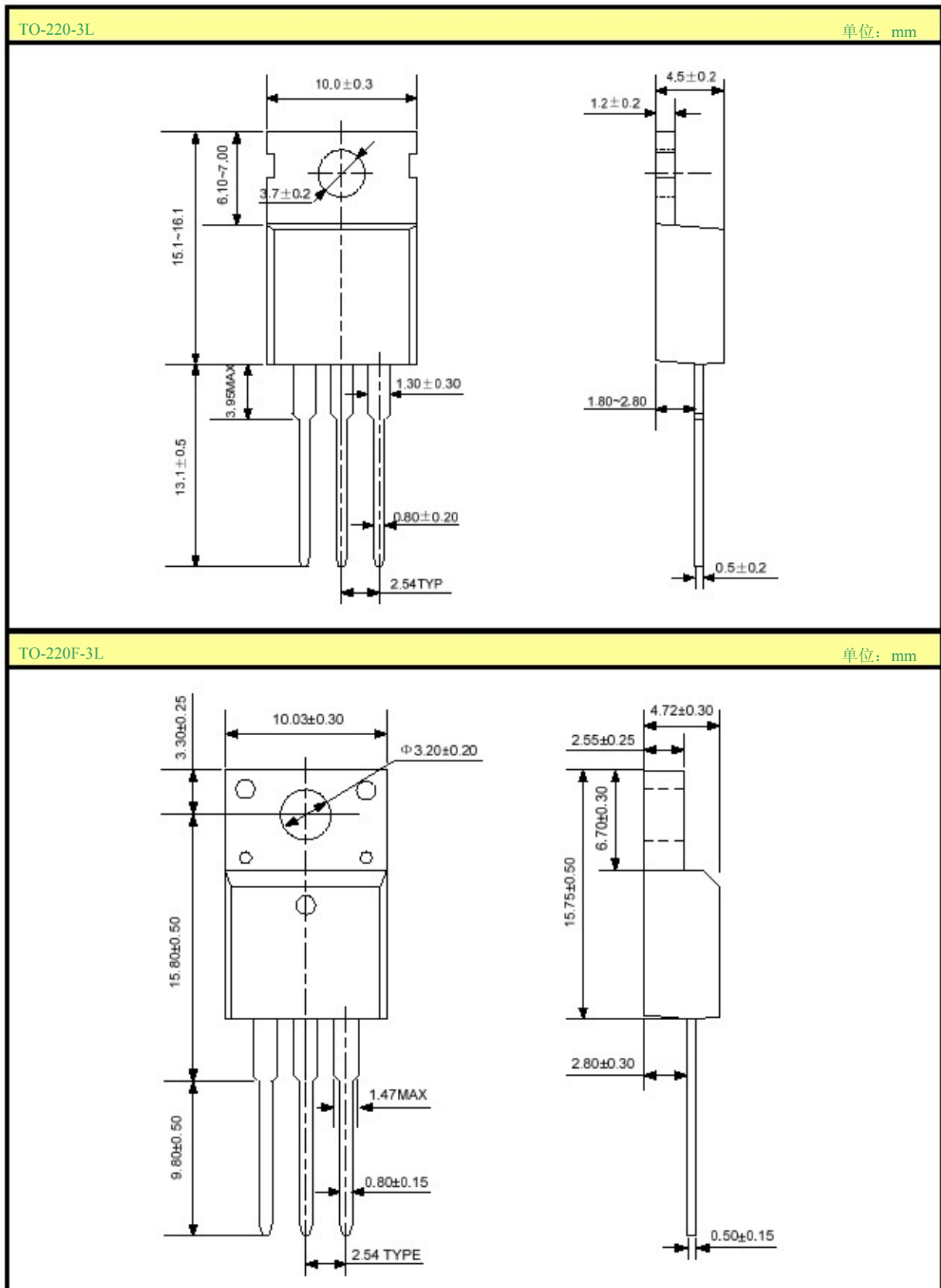


EAS测试电路及波形图





封装外形图





SVF10N60AT/F 说明书

声明:

- SL保留说明书的更改权, 恕不另行通知! 客户在下单前应获取最新版本资料, 并验证相关信息是否完整和最新。
- 任何半导体产品特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能, 买方有责任在使用 Silan 产品进行系统设计和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施, 以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生!
- 产品提升永无止境, 我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品!

附:

修改记录:

日期	版本号	描 述	页码
2011.01.26	1.0	原版	
2011.02.18	1.1	增加TO-220-3L封装	
2011.08.30	1.2	修改“封装外形图”	

SL一级授权总代理: 昆山东森微电子有限公司

手机: 15950933050

电话: 0512-50710709

传真: 0512-50111209

MSN: wei_126@hotmail.com

Q Q: 41086900

网站: <http://www.ksmcu.com>